

## **龙迅半导体（合肥）股份有限公司**

### **关于对外投资设立新加坡全资子公司的进展公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、对外投资概述**

龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立新加坡全资子公司的议案》，同意公司以自有资金在新加坡投资设立全资子公司Lontium Singapore Pte. Ltd.（以下简称“新加坡子公司”），投资总额1,000万美元。具体内容详见公司2023年9月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙迅股份关于对外投资设立新加坡全资子公司的公告》（公告编号：2023-027）。

#### **二、对外投资的进展情况**

近日，公司新加坡子公司已完成注册登记手续，并取得注册证书，相关登记信息如下：

- 1、公司名称：LONTIUM SINGAPORE PTE. LTD.；
- 2、注册时间：2023年12月22日；
- 3、注册号：202350067D；
- 4、公司类型：私人股份有限公司；
- 5、注册地址：6 RAFFLES QUAY #14-02 SINGAPORE (048580)；
- 6、注册资本：100万美元；
- 7、股权结构：龙迅股份（英文名Lontium Semiconductor Corporation）持股100%；

8、经营范围：电子产品的研究及开发（医学除外）：芯片产品的研发设计、生产、销售及相关的技术咨询服务；软件和应用程序的开发（游戏和网络安全除外）：软件和应用程序的设计、生产、销售和技术服务。

特此公告。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

2023年12月26日